证券代码：688469　　证券简称：芯联集成　　公告编号：2026-045

芯联集成电路制造股份有限公司

首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,034,800股。

本次股票上市流通总数为2,034,800股。

- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）169,200 万股（行使超额配售选择权之前），并于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 507,600 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 676,800 万股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行人民币普通股（A 股)股票超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日全额行使，对应新增发行股数 25,380 万股，由此公司总股本增加至 702,180 万股，其中有限售条件流通股 5,981,223,727 股，占公司发行后总股本的 85.18%，无限售条件流通股 1,040,576,273 股，占公司发行后总股本的 14.82%。

本次上市流通的限售股为公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权（以下简称“本次期权行权”）限售股，限售期为自行权日起三年。本次上市流通的限售股数量为 2,034,800 股，股东数量为 41 人，占截至本公告披露之日公司总股本比例为 0.024%。该部分限售股将于 2026 年 11 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）股票期权激励计划行权

因公司实施《第一期股票期权激励计划》，公司股本在本次期权行权后因第一期股票期权激励计划的行权登记合计新增 26,517,725 股，公司总股本由 7,042,567,475 股变更为 7,069,085,200 股，具体情况如下：

序号	股份变动日期	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2023 年 11 月 27 日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权	2,034,800	《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）
2	2024 年 2 月 5 日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权	1,144,875	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-010）
3	2024 年 5 月 7 日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权	893,850	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）
4	2024 年 6 月 27 日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权	7,016,113	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）
5	2024 年 11 月 26 日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权	5,429,900	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-086）
6	2025 年 1 月 23 日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第三次行权	2,758,137	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）
7	2025 年 3 月 20 日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第四次行权	7,240,050	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007）
合计			26,517,725	-

（二）发行股份及支付现金购买资产事项

公司发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 9 月 3 日出具了《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份 1,313,601,972 股，登记后股份总数 8,382,687,172 股。具体内容详见《芯联集成电路制造股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-048）。

（三）本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据相关法律法规和公司股票期权激励计划的规定，本次期权行权新增股份自行权日起 3 年内不得减持。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，芯联集成本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。芯联集成本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其做出的股份锁定承诺。

芯联集成关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对芯联集成本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,034,800 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 11 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员			
本次无董事、高级管理人员及核心技术人员参与行权。			
二、其他激励对象			
1	其他激励对象（合计 41 人）		2,034,800
合计			2,034,800

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权限售股	2,034,800
合计		2,034,800

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日